



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090113001D
2010 年 11 月 12 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト) 一部製品 前処理サイト変更のご案内 (認定済 51 製品への追加認定 1 製品の連絡)

(第四版 PCN20090113001C 2009 年 11 月 19 日発行, 第三版 PCN20090113001B 2009 年 9 月 9 日発行)
(第二版 PCN20090113001A 2009 年 9 月 3 日発行, 初版 PCN20090113001 2009 年 3 月 18 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただきます。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

| | | | | |
|--------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 通知タイプ | <input type="checkbox"/> Initial notice (Plan) | <input checked="" type="checkbox"/> Final notice | | |
| 変更概要 | Design/Specification | <input type="checkbox"/> Design | <input type="checkbox"/> Electrical | <input type="checkbox"/> Mechanical |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab | <input checked="" type="checkbox"/> Site | <input type="checkbox"/> Process | <input type="checkbox"/> Material |
| | Wafer Bump | <input type="checkbox"/> Site | <input type="checkbox"/> Process | <input type="checkbox"/> Material |
| | Assembly | <input type="checkbox"/> Site | <input type="checkbox"/> Process | <input type="checkbox"/> Material |
| | Test | <input type="checkbox"/> Site | <input type="checkbox"/> Process | |
| | Others | <input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling | <input type="checkbox"/> - | |
| 変更内容 | 下記変更について認定済 51 製品への追加認定 1 製品の連絡になります。 ASP 一部製品 前処理サイト変更 現行 : TI-MIH06(日本)サイト 変更後: TI-HIJI(日本)サイト | | | |
| 対象製品 | 対象製品リスト参照 | | | |
| 変更時期 | 追加認定品は 2011 年 4 月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルは 2011 年 3 月上旬の出荷より予定しています。) 認定終了品は 2009 年 6 月下旬の出荷より実施しています。 | | | |
| 品質認定試験 | <input type="checkbox"/> 計画 | <input checked="" type="checkbox"/> 終了 | | |
| 製品表示 | <input type="checkbox"/> 変更無し | <input checked="" type="checkbox"/> 変更あり | | |
| 備考 | - | | | |

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更について認定済 51製品への追加認定 1製品の連絡になります。弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト) 一部製品 前処理サイトについて、現行 TI-MIH06(日本)サイトにて製造いたしておりますが、TI-MIH06サイト製造終了の為、これに替えて、TI-HIJI(日本)サイトでの製造に移行し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

| | | |
|--------|--------------|-------------|
| 変更内容 | 現行 | 変更後 |
| 前処理サイト | TI-MIH06(日本) | TI-HIJI(日本) |

理由: TI-MIH06 サイト製造終了の為

対象製品リスト

| 対象製品名 | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| ■:追加認定品 □:認定終了品 | | | | |
| D12945PN | TMS320BC51PQA57 | TMS320BC52PZ100 | TMS320C30GEL40 | TMS320C50PQA57 |
| D17222PZ | TMS320BC51PQA80 | TMS320BC52PZ57 | TMS320C30GEL50 | TMS320LBC51PQA57 |
| D172B1PJ92G4 | TMS320BC51PQA80G4 | TMS320BC52PZ80 | TMS320C31PQA40 | TMS320LBC51PZA57 |
| D17807PJ | TMS320BC51PZ100 | TMS320BC52PZ80G4 | TMS320C31PQA50 | TMS320LBC52PZA57 |
| D17807PJR | TMS320BC51PZ57 | TMS320BC52PZA57 | TMS320C31PQL40 | TMS320LBC51PQA57 |
| D17807PJRG4 | TMS320BC51PZ80 | TMS320BC53PQ57 | TMS320C31PQL50 | TMS320LBC50PQ50 |
| D72931PN | TMS320BC51PZA57 | TMS320BC53PQ80 | TMS320C31PQL60 | TMS320LBC50PQ57 |
| DM206002PGA | TMS320BC52PJ100 | TMS320BC57SPGE57 | TMS320C31PQL80 | TMS320LBC50PQA |
| TMS320BC51PQ100 | TMS320BC52PJ57 | TMS320BC57SPGE80 | TMS320C50PGEA57 | |
| TMS320BC51PQ57 | TMS320BC52PJ80 | TMS320C209PN57 | TMS320C50PQ57 | |
| TMS320BC51PQ80 | TMS320BC52PJA57 | TMS320C30GEL | TMS320C50PQ80 | |

製品表示

この変更に伴い、製品捺印の FAB CODE が "H" (TI-MIH06) から "J" (TI-HIJI) に変更されます。

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|------------|
| 信頼性試験期間 | 開始 | — | 終了 | 2009年11月1日 |
| 信頼性試験 - 試料構成詳細 | | | | |
| Device: | D12945PN | - | - | |
| Wafer Fab: | HIJI | Wafer Technology: | 50C18.23 | |
| Assembly Site: | PHI | Package Code/Pins: | PN/80 | |
| 信頼性試験結果 | | | | |
| Reliability Test | Condition / Duration | | Sample Size/ Fails | |
| **Autoclave | 121C, 168 Hours | | 231/0 | |
| **Temp Cycle | -65/150C, 1000cyc | | 201/0 | |
| Life Test | 125C, 6.5V, 1000 Hours | | 348/0 | |
| **Storage Bake | 150C, 1000 Hours | | 231/0 | |
| ESD-HBM | 2.0 kV | | 9/0 | |
| Latch-up | 250 mA per I/O, 7.5Vccmax at room temp | | 15/0 | |
| Manufacturability | per mfg. site specification | | Approved | |
| Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-1/260C | | | | |

信頼性試験結果

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 信頼性試験期間 | 開始 | — | 終了 | 2009年11月1日 |
| 信頼性試験 - 試料構成詳細 | | | | |
| Device: | TMS320C50PQ57 | - | - | |
| Wafer Fab: | HIJI | Wafer Technology: | 50C18.22 | |
| Assembly Site: | PHI | Package Code/Pins: | PQ/132 | |
| 信頼性試験結果 | | | | |
| Reliability Test | Condition / Duration | | Sample Size/ Fails | |
| **Autoclave | 121C, 240 Hours | | 231/0 | |
| **Temp Cycle | -65/150C, 1000cyc | | 231/0 | |
| ESD-HBM | 2.0 kV | | 9/0 | |
| Latch-up | 200mA & 1.5x Vmax | | 15/0 | |
| Manufacturability | per mfg. site specification | | Approved | |
| Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-4/260C | | | | |

信頼性試験結果

| | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 信頼性試験期間 | 開始 | — | 終了 | 2009年11月1日 |
| 信頼性試験 - 試料構成詳細 | | | | |
| Device: | TMS320C30GEL | - | - | |
| Wafer Fab: | HIJI | Wafer Technology: | 50C18.2 | |
| Assembly Site: | PHI | Package Code/Pins: | GE/181 | |
| 信頼性試験結果 | | | | |
| Reliability Test | Condition / Duration | | Sample Size/ Fails | |
| ESD-HBM | 2.0 kV | | 3/0 | |
| Latch-up | 250mA & 2x Vmax | | 5/0 | |

信頼性試験結果

| | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 信頼性試験期間 | 開始 | — | 終了 | 2009年11月1日 |
| 信頼性試験 - 試料構成詳細 | | | | |
| Device: | TMS320C31PQA40 | - | - | |
| Wafer Fab: | HIJI | Wafer Technology: | 50C18.22 | |
| Assembly Site: | PHI | Package Code/Pins: | PQ/132 | |
| 信頼性試験結果 | | | | |
| Reliability Test | Condition / Duration | | Sample Size/ Fails | |
| ESD-HBM | 2.0 kV | | 3/0 | |
| Latch-up | 250mA & 2x Vmax | | 5/0 | |